

第91回レーザー加工学会 講演会 大阪大学 銀杏会館 (予告プログラム)

1日目 2019年6月20日(木)

ホール			
10:00	開会の辞		
10:05	ポスターショートプレゼンテーション(各2分間, ホール) + ポスタープレゼンテーション	佐野 智一 (大阪大学)	
	ポスター講演		ポスター展示
			カタログ展示
1	サブマイクロ秒Yb:YAGディスクレーザを用いた各種材料除去加工に対するパルス幅の	刀原 寛孝 ((株)ナノプロセス)	レーザーライン株式会社
			パルステック工業株式会社
2	青紫色半導体レーザを用いて高ビーム品質を実現した微細加工用光源	出島範宏 日亜化学工業(株)	株式会社プロフィット
			株式会社ノビテック
3	>40mJジャイアントパルス手の平μCHIPレーザの開発	橋本知也 (株)ユニタック	株式会社島津製作所
			株式会社アルプスエンジニアリング
4	プラズマ閉じ込め層を固体とした際のレーザピーニング効果	杉本優樹 近畿大学	パルステック工業株式会社
			スペクトロニクス株式会社
5	アルミナセラミックスに対するレーザピーニング効果	安好 祐哉 近畿大学	株式会社安川電機
			株式会社ユニタック
6	蓄熱の影響を考慮したガラスの超短パルスレーザ加工シミュレーション	魏 超然 東京大学	光産業創成大学院大学
			株式会社オフィールジャパン
7	レーザを用いた付加工に関するレーザと金属粉末の相互作用に関する数値計算	大久保友雅 東京工科大学	株式会社ノビテック
8	WC-Co造粒焼結粉を用いた超硬合金のレーザ肉盛における気孔欠陥の発生におよぼす雰囲気中酸素濃度の影響	山口拓人 大阪産業技術研究所	前田工業株式会社
9	青色半導体レーザの波長が純銅箔の溶接に及ぼす影響	森本健斗 大阪大学	株式会社ユニタック
10	めっき複合炭化物を利用したレーザ肉盛層の割れ低減に関する研究	萩野秀樹 大阪産業技術研究所	株式会社ナ・デックス
			IPGフォトリニクスジャパン株式会社
			愛知産業株式会社
昼食休憩(12:00~13:00)			
阪急電鉄・三和銀行ホール			
プレナリーセッション		田中 健一郎 (パナソニック(株))	
13:00	【基調講演1】金属積層造形(主に電子ビーム方式)技術の特徴と課題	千葉 晶彦 (東北大学)	
13:50	【基調講演2】光造形アディティブ・マニファクチャリングによる材料テクニクスの実践	桐原 聡秀 (大阪大学)	
総会 (14:40~15:10)			
Coffee break (15:10~15:20)			
HPL&LPMジョイント : 阪急電鉄・三和銀行ホール			
20A1	アディティブマニファクチャリング	三瓶和久 (株)タマリ工業)	
15:20	【特別講演】パナソニックにおける3Dプリンティング技術の活用と今後の展望	寺西 正俊 (パナソニック(株))	
16:00	金属積層造形用粉末を製造するためのガスアトマイズ条件適正化	山田 武利 (三菱製鋼(株))	
16:30	大型部品向け金属積層造形技術と、産業応用	木寺 正晃 (愛知産業(株))	
17:00	Metallic Additive Manufacturing at TWI: Capabilities and Case Studies	Fred Delany (TWI)	
17:30	終了		
懇親会 (17:45~19:30) ポスター講演優秀発表			

第91回レーザー加工学会講演会 大阪大学 銀杏会館 (予告プログラム)

2日目 2019年6月21日(金)

ホール		大会議室			
21A1	レーザープロセスの基礎現象	山本 元道 (広島大学)	21B1 ImPACTプログラムにおける超小型パワーレーザーの開発とその応用	佐野 智一 (大阪大学)	
9:30	【特別講演】合金元素塗布層を用いた鉄鋼材料のレーザー溶融焼入れ	川上 博士 (三重大学)	9:30	【特別講演】マイクロチップ小型集積パワーレーザーの開発	平等拓範 (理化学研究所/分子科学研究所)
10:10	レーザー溶接中の温度計測	山下 正太郎 (大阪大学)	10:10	レーザー超音波による溶接欠陥リアルタイム検出システムの開発	浅井 知 (大阪大学)
10:40	高輝度X線透過装置を用いた動的観察手段による超ハイトン鋼板の重ねレーザー溶接で発生する遅れ割れ挙動の解明	前田 恭兵 ((株)神戸製鋼所)	10:40	パルスレーザーによる固液界面の爆発的気化を用いた金属に付着した液体のクリーニング	岡田直忠 ((株)東芝)
11:10	大出力レーザーによる高温割れ防止工法の開発	出口 貴大 ((株)ナ・テックスプロダクツ)	11:10	眼科応用を目指したマイクロチップレーザー	足立宗之 ((株)ニテック)
昼食休憩 (11:40~12:40)					
ホール		大会議室			
21A2	高出力レーザーの産業利用	木谷靖 (JFEスチール(株))	21B2 レーザマニピュレーションとその応用	西山 宏昭 (山形大学)	
12:40	【特別講演】圧延クラッド鋼板製造プロセスへの大出力真空レーザー溶接の適用	沖田 泰明 (JFEスチール(株))	12:40	【特別講演】光放射圧制御マイクロ球を利用したナノ加工・計測の展開	高谷 裕浩 (大阪大学)
13:20	レーザー・アークハイブリッド溶接技術の一般商船建造工程への導入に向けた研究	後藤 浩二 (九州大学)	13:20	レーザー誘起流体現象に基づく生化学反応の光誘導加速システムの開拓	飯田 琢也 (大阪府立大学)
13:50	高出力ダイレクトLD発振器の最新動向とその加工適用例	武田 晋 (レーザーライン(株))	13:50	レーザーリフトオフによるプラズマモニク光触媒材料の創製と水素発生	村井 健介 (産業技術総合研究所)
14:20	ダイレクトダイオードレーザーを用いた加工システムの新展開	中川 龍幸 (パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株))	14:20	【特別講演】材料表面機能性付加のための短パルスレーザー加工	橋田 昌樹 (京都大学)
Coffee break (14:50~15:10)					
ホール		大会議室			
21A3	ビームプロファイル制御による溶接・切断	王静波 (パナソニックスマートファクトリーソリューションズ(株)) 佐藤雄二 (日本原子力研究開発機構)	21B3 表面処理	溝尻 瑞枝 (長岡技術科学大学)	
15:10	ビームプロファイル制御BrightLine Weldによる溶接品質の改善	中村 強 (トルンプ(株))	15:10	【特別講演】マクロとマイクロにビーム整形及びナノマテリアル創成	中田 芳樹(大阪大学)
15:40	レーザー溶接用ビーム制御技術と応用加工事例	齊藤 準一 ((株)アマダ)	15:50	低フルーエンス数サイクルレーザーパルスによるDLC表面へのナノ構造生成	宮地 悟代 (東京農工大学)
16:10	三菱電機におけるビームプロファイル制御技術とその適用例	平野 孝幸 (三菱電機(株))	16:20	レーザーを利用した金属表面の濡れ性制御への試み ~レーザー照射面の濡れ性について考える~	水谷 正義 (東北大学)
16:40	ビームシェーピング技術とその加工事例	奈良拓治 ((株)プロフィット)			
17:10	終了		16:50	終了	

時間、内容に一部変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。